

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2016-083

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于承担国家02专项及收到政府研发补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 29 日确认作为课题责任单位承担“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项（简称“02 专项”）项目“20-14nm 先导产品工艺开发”的课题“铜互连电镀工艺技术及产品的研发”的研发任务，并于当日收到中央财政研发补助款 657.05 万元。具体情况如下：

一、项目简介

专项名称：极大规模集成电路制造装备及成套工艺

项目编号：2016ZX02301

项目名称：20-14nm 先导产品工艺开发

课题编号：2016ZX02301003-004-006

课题名称：铜互连电镀工艺技术及产品的研发

课题责任单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

课题组长：王溯

起止年限：2016 年 1 月至 2018 年 12 月

二、关于补助金额及补助款项拨款进度

根据国家科技重大专项课题任务合同书中课题经费来源与支出预算核定表显示，本项目研发补助款项按照项目预算分三年拨付，进度计划如下：

资金来源	2016年度	2017年度	2018年度	合计
中央财政支持	657.05万元	735.70万元	343.64万元	1,736.39万元
地方财政支持	350.58万元	329.33万元	188.28万元	868.19万元
企业自筹	608.08万元	1,155.44万元	1,351.07万元	3,114.59万元

合计	1,615.71万元	2,220.47万元	1,882.99万元	5,719.17万元
----	------------	------------	------------	------------

实际补助金额和进度以到账金额和时间为准。

三、财务核算方式及对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司于收到上述研发补助款项时计入递延收益，后期陆续收到的政府研发补助均按此处理。上述研发补助款项专门用于20-14nm先导产品工艺开发之铜互连电镀工艺技术及产品的技术研发，公司将会根据款项的使用进度，在研发费用发生时确认营业外收入，对公司财务报表当期净利润不会产生重大影响。具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。

四、其他风险提示

公司20-14nm先导产品工艺开发之铜互连电镀工艺技术及产品的技术研发存在的风险主要为技术开发风险。具体来说，20-14nm集成电路工艺留给电镀的时间将少于5秒，且受新材料Low-k材料的不确定性影响——相对90nm、45nm的电镀工艺技术，20-14nm的芯片铜互连电镀工艺技术难度已达到前所未有的高度；对20nm及以下技术节点的高端产品，经阻挡层及种子层后ECP镀铜开口变得极小，AR比可高达20，对添加剂填孔能力和电镀工艺提出了超高的要求；PVD工艺改变将给ECP镀铜带来全新的挑战；由于20-14nm技术节点布线及沟槽的更微细化并出现新的介质层，对清洗液的清洗能力、与各种材料的兼容性和润湿性能的全面提升提出了更高的要求；上述难点都有可能导致技术开发风险。

截止本公告日，公司尚未收到地方财政研发补助款项，公司将根据项目实际进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2016年11月29日